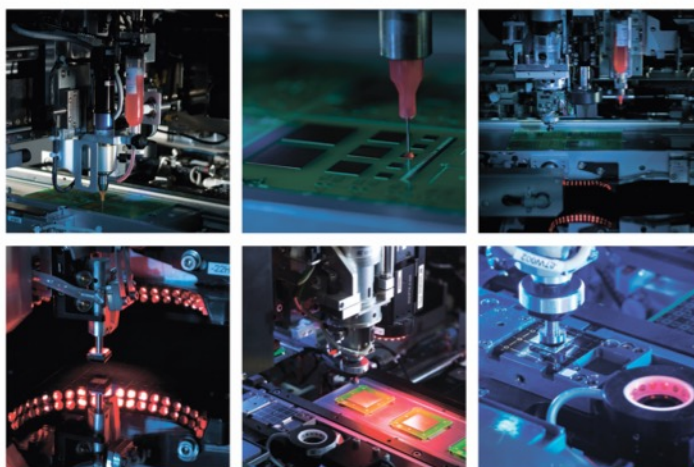


СИСТЕМА МОНТАЖА КРИСТАЛЛОВ

Универсальная система монтажа кристаллов модели **Datacon 2200 evo** является наиболее гибким в настройке и конфигурировании различными опциями решением на рынке для высокоточного монтажа кристаллов и компонентов для лабораторного и серийного производства.

Система монтажа кристаллов модели **Datacon 2200 evo** позволяет осуществлять монтаж кристаллов, монтаж флип-чип кристаллов и монтаж многоуровневых кристалльных сборок. Установка может быть оснащена системой дозирования для монтажа на клей, а также модулем штемпелевания и флюсования. Система может быть также сконфигурирована для пайки компонентов на эвтектический припой в среде защитной атмосферы.



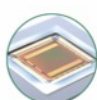
Система автоматического монтажа компонентов **Datacon 2200 evo** может работать как с носителями кристаллов типа Waffle и GelPak, так и с пластинами на плёночном носителе на рамках. Для задач с высокой производительностью система оснащается буфером загрузки и выгрузки подложек.



ОСОБЕННОСТИ

- ▲ Интегрированная система дозирования клея включая модуль штемпелевания
- ▲ Оптическая система для точного совмещения и позиционирования
- ▲ Автоматическая смена инструментов монтажа и носителей кристаллов
- ▲ Универсальная рабочая голова для монтажа кристаллов

ТИПОВЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ

-  Сборка электронных узлов для мобильной техники, медицинских приборов и автомобильной аппаратуры
-  Сборка силовых приборов, систем в корпусе и ГИС
-  Сборка светодиодов, датчиков изображения и модулей памяти



СИСТЕМА DATACON 2200 EVO

Преимущества системы

- Возможность установить до 4 рабочих головок в одной системе
- Производительность до 7000 компонентов в час
- Возможность осуществлять монтаж кристаллов, монтаж флип-чип кристаллов, и собирать многокристальные, многоуровневые сборки в одной системе
- Возможность монтажа на клей, методом штемпелевания и флюсования
- Возможность монтажа кристаллов с пластины, носителей типа Waffle- и Gel-pak, а также монтаж компонентов из питателей
- Возможность монтажа на подложку, печатную плату, корпус, выводную рамку, а также на полупроводниковую пластину
- Поддержка «холодного» и «горячего» монтажа компонентов - монтаж на клей, на припой, монтаж методом термокомпрессии
- Максимальная производительность при компактных габаритах системы



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ DATACON 2200 EVO

Точность монтажа кристаллов

Стандартно ± 10 мкм при 3σ , опционально ± 7 мкм

Подогрев рабочей головы

До 350°C

Усилие прижима

Программируемое от 0 до 7500 г

Размер кристаллов

От 0,17 мм до 50 мм

Размер флип-чип кристаллов

От 0,8 мм до 50 мм

Толщина кристаллов

От 0,02 мм до 7 мм

Размер пластины

От 100 до 300 мм

Ширина ленты питателя

От 8 мм до 44 мм

Типы подложек

FR4, керамика, BGA, гибкие подложки, оснастка, выходные рамки, waffle pack, Gel-Pak®, JEDEC-трей

Максимальный размер подложки

330 мм x 200 мм

Дозатор

Давление/время, шнековый

Резервуар для клея в модуле штемпелевания

Глубина резервуара от 0,1 мм до 5 мм

Резервуар для флюсования

Доступны любые размеры по запросу

Требования по подключению, габариты и масса

Сжатый воздух: 6 атм, расход до 120 л/мин

Напряжение питания: 380 В переменного тока, 50 Гц, три фазы, 2,5 кВт

Габариты (ШxГxВ): 1200 x 2000 x 1225 мм³ для прямоугольной формы рабочего стола

Масса: 1300кг